

各 位

株式会社 JCU

代表取締役会長兼 CEO 小澤 恵二

## 工場内で廃液処理ができるプリント基板用 DFR 剥離薬品を開発 JCU が環境負荷の高いアミン使わず低濃度を実現、剥離性能と両立

株式会社 JCU（代表取締役会長兼 CEO：小澤恵二）は、プリント基板などのめっきパターン形成に用いる無機アルカリ系のドライフィルムレジスト（DFR：Dry Film Resist）剥離薬品を開発しました。DFR 剥離薬品は、基板上に銅配線（回路）を形成する際に、型枠として使用した樹脂フィルム（DFR）を除去するための薬品（図 1）です。環境負荷の高い有機系のアミンに代わって無機系の薬品が使われるようになっていますが、剥離性能と、廃液の排出基準指標である COD（化学的酸素要求量）の高さが課題となっています。そこで JCU は、「ユーザーの工場内で廃液処理ができること」を目指し、微細な配線での剥離性能と両立させた無機アルカリ系の剥離薬品を開発しました。具体的には、DFR に浸透性の高い成分を使用し、剥離性能を従来の無機系薬品より向上させたうえに、COD を当社従来品に比べ約 15 分の 1 に抑え、外部業者に委託せずに廃液処理をできるようにしたことが特長です。これにより、水質汚染の抑制に貢献してまいります。

本開発品は、廃水規制が厳しくなることが予想される中国をはじめ日本、台湾、ベトナムなどへの拡販を目指します。まず年 3 億～5 億円の売り上げを目標にシェア拡大を図ってまいります。

ユーザーの工場内での廃液処理は、中和、凝集剤による沈降処理によって行います。水中の被酸化物質を酸化するために消費される酸化剤が少量で済む低 COD 薬品のため、業者に委託せずに処理することが可能となり、処理コストが低下します。当社は CSV（共通価値の創造）、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献を見据えながら、主力製品である硫酸銅めっき薬品に加え、半導体パッケージ基板、プリント基板製造に欠かすことのできない表面処理薬品のラインナップを強化してまいります。

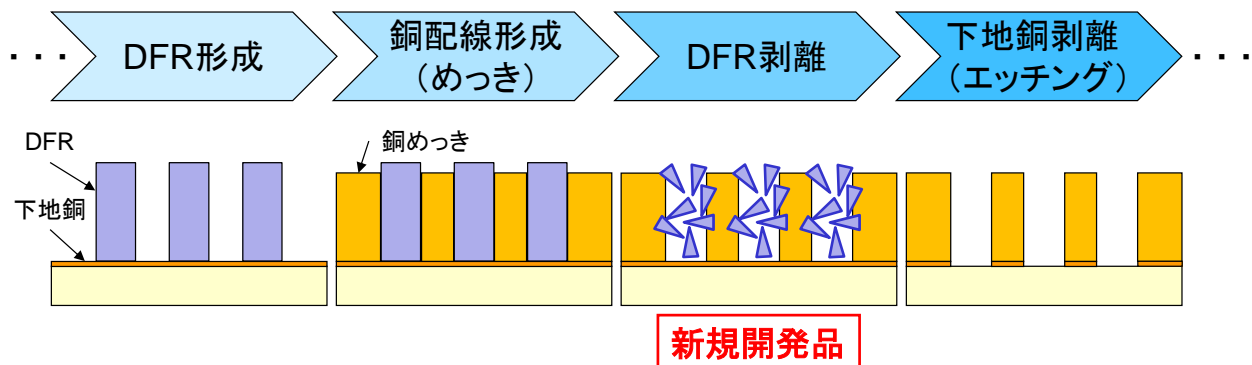


図 1 プリント基板製造における配線形成フローの一部

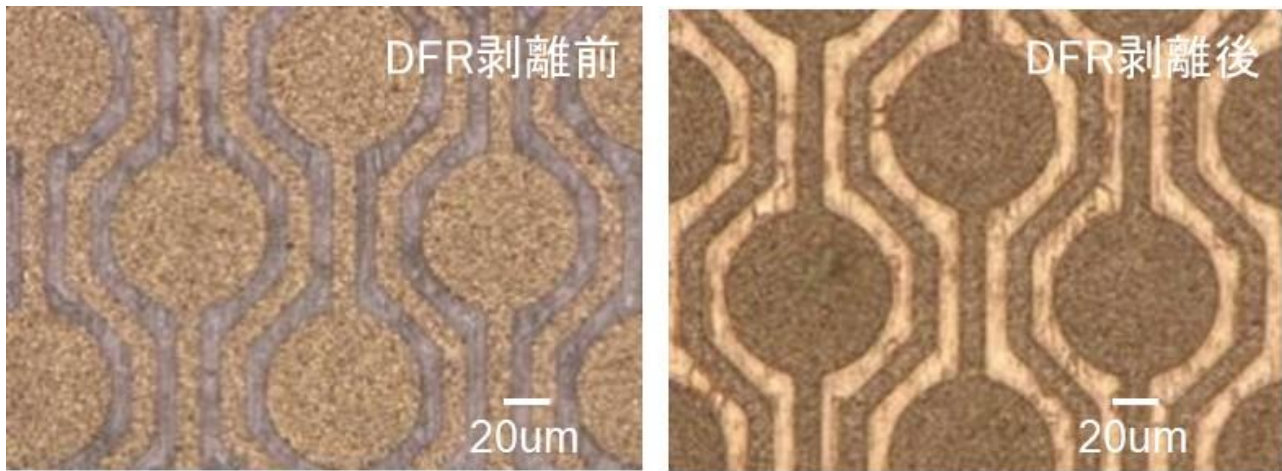


図 2 DFR 剥離処理試験結果

SDGs（持続可能な開発目標）



【本件の問い合わせ先】

株式会社 JCU 経営戦略室 広報・IR 課 橋本康男

TEL : 03-6895-7004 FAX : 03-6895-7022 E-mail : [kikaku@jcu-i.com](mailto:kikaku@jcu-i.com)

以上